

平成26年8月18日

## 電子情報通信学会

# 12月 シリコン材料・デバイス研究会・電子ディスプレイ研究会の 開催と論文募集の御案内

拝啓 皆様には、研究開発にご精励のこととご推察申し上げます。

平素より電子情報通信学会シリコン材料・デバイス(SDM)研究会および電子ディスプレイ(EID)研究会にご関心とご理解を賜りまして誠に有難うございます。本年は、SDMおよびEID共催の研究会を京都大学桂キャンパスにて、下記の要領で開催することになりました。奮ってご応募を頂きますようご案内申し上げます。なお、お近くの方にもご回覧下さいませようお願い致します。

敬具

担当委員 SDM 冬木(奈良先端大)、平野(松下電器)、木本(京都大)  
EID 木村(龍谷大)

### 記

1. テーマ： 「シリコン関連材料の作製と評価およびディスプレイ技術」  
(Si、Siを含む材料の作製、プロセス技術、デバイス、およびディスプレイ関連技術)
2. 開催日： 平成26年12月12日(金) (研究会終了後に懇親会を予定)
3. 開催場所： 京都大学桂キャンパス A1棟 地階 第1講義室  
(京都市西京区京都大学桂：阪急京都線「桂」駅からバス15分)  
[http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r\\_k.htm](http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_k.htm)
4. 発表申込締切：平成26年10月10日(金)
5. 申込方法：  
発表申し込みの Web ページ(<http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=SDM>)より、発表題目・著者・発表者・所属・論文概要(100文字程度)・連絡先を記入してお申込み下さい。受付後、「技術研究報告」の執筆を依頼させていただきます。なお、原稿締め切り日は開催日の約3週間前です。
6. 参加要領：
  - ・ 第一種研究会ですので参加費は無料、予稿集は別売です。
  - ・ 事前の参加申込は必要ありません。
7. お問い合わせ先：  
京都大学工学研究科電子工学専攻 木本 恒暢  
E-mail: [kimoto@kuee.kyoto-u.ac.jp](mailto:kimoto@kuee.kyoto-u.ac.jp)  
〒615-8510 京都市西京区京都大学桂 Tel: 075-383-2300 Fax: 075-383-2303